

2020年7月14日

DIC株式会社

〒103-8233 東京都中央区日本橋 3-7-20
ディーアイシービル

太陽インキ製造と共同開発した「高周波対応配線形成用新シードフィルム」が

第16回 JPCA 賞（アワード）を受賞

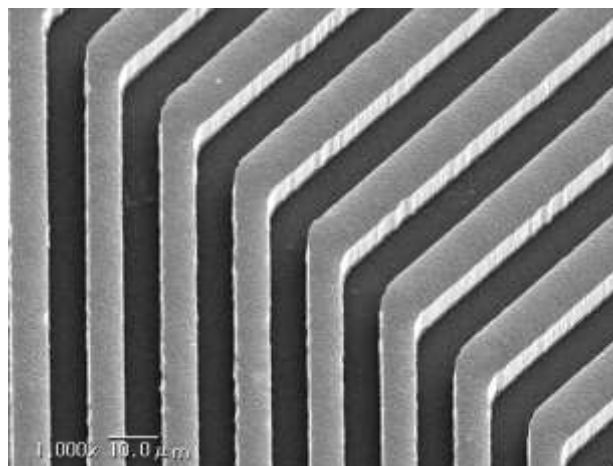
— 5 G通信における高周波伝送損失を低減できる技術として高く評価されました —

D I C株式会社（本社：東京都中央区、社長執行役員：猪野薫）は、太陽ホールディングス株式会社（本社：東京都豊島区、代表取締役社長：佐藤英志）の子会社である太陽インキ製造株式会社（本社：埼玉県比企郡嵐山町、代表取締役社長：峰岸昌司、以下、「太陽インキ」）と共同開発した「高周波対応配線形成用新シードフィルム」が第16回 JPCA 賞[※]（アワード）を受賞したことをお知らせします。

本開発品は、次世代通信規格5 Gの高周波帯域で使用される電子機器向けに太陽インキと共同開発したもので、当社の金属ナノ粒子材料をフレキシブルプリント配線板用に展開するために開発したフィルム材料です。本フィルムに塗工されているD I Cの金属ナノ粒子は、銅配線形成時のシード層として用いられ、めっき法の1つであるセミアディティブ・プロセスの導電層として使用します。このシード層は、銅パターン形成後に取り除く必要がありますが、シード層を銅とは異なる金属種とすることで、形成した銅配線を劣化させずにシード層のみを削除することができます。そのため、銅配線の表面は非常に平滑となり、5 G通信で使用される高周波を伝送する銅配線として、伝送損失を大幅に低減できます。



高周波対応配線形成用新シードフィルム



本開発品による銅配線形成例 銅配線の厚み=8μm

斜め配線 L/S=10/10 縦配線 L/S=8/8(um)

なお、今回の太陽インキの JPCA 賞受賞理由として審査員の方々からは「高周波において期待できる技術として高く評価した」とのコメントを頂きました。

当社グループは、2017 年から太陽ホールディングス株式会社と資本業務提携を行っており、シナジー効果の発揮に向けて相互協力関係を構築および強化するための取り組みを行ってきました。今回の太陽インキの受賞がその具体的な成果として評価されたことを大変喜ばしく思います。今後もさらに本資本業務提携によるシナジーを活かし、更なる成長の基軸となる事業を構築し、将来にわたる発展に繋げていく所存です。

※ JPCA 賞（JPCA : Japan Electronics Packaging and Circuits Association）とは

一般社団法人日本電子回路工業会が主催・運営する「JPCA Show 2020（第 50 回国際電子回路産業展）」の展示会全出展者を対象としたアワードです。同賞は電子回路技術および産業の進歩発展に貢献した製品・技術への表彰制度として 2005 年に創設され、2020 年は 4 件が「第 16 回 JPCA 賞（アワード）」として選出されました。なお、予定されていた展示会及び表彰式は新型コロナウイルス感染症の感染防止のため、中止されました。

以上

－参考

■ 太陽ホールディングス株式会社 ニュースリリース

http://www.taiyo-hd.co.jp/_cms/wp-content/uploads/2020/06/20200626_01.pdf

■ 受賞論文全文：高周波対応配線形成用新シードフィルム（会社名：太陽インキ製造株式会社）

https://www.jpca-show.com/show2020/common/pdf/JPCAaward2020_taiyo.pdf

－関連ニュースリリース

■ 太陽ホールディングス株式会社との資本業務提携（持分法適用会社化）に関するお知らせ（2017 年 1 月 25 日）

https://www.dic-global.com/ja/news/news_file/file/20170125_01.pdf